

## PODŁOGA/PARKING

$$\lambda_D \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$$



Płyty styropianowe **PODŁOGA/PARKING** to materiał termoizolacyjny uzyskiwany w procesie spieniania granulek polistyrenu, następnie formowania i cięcia. Oznaczone są zgodnie ze specyfikacją techniczną obowiązującą dla tego wyrobu tj. normą EN 13163:2012 poniższym kodem:

**EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S<sub>b</sub>5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5**

### Parametry techniczne płyt styropianowych PODŁOGA/PARKING

PARAMETR	KLASA LUB POZIOM	TOLERANCJA
Grubość	T2	±2 mm
Długość	L3	± 0,6 % lub ±3 mm
Szerokość	W3	± 0,6 % lub ±3 mm
Prostokątność	S <sub>b</sub> 5	±5 mm
Płaskość	P10	±10 mm
Wytrzymałość na zginanie	BS200	≥200 kPa
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym	CS(10)150	≥150kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych	DS(N)5	±0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności ( temp.70 °C, 48 h)	DS(70,-)2	≤ 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT(1)5	≤5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$	0,035 W/mK	
Klasa reakcji na ogień	E	

### Deklarowane wartości oporu cieplnego $R_D$ w zależności od grubości

Grubość mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Opór cieplny $R_D$ m <sup>2</sup> K/W	0,25	0,55	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40	3,70
Grubość mm	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	
Opór cieplny $R_D$ m <sup>2</sup> K/W	4,00	4,25	4,55	4,85	5,10	5,40	5,70	6,00	6,25	6,55	6,85	7,10	

## Zastosowanie

Płyty styropianowe PODŁOGA/PARKING należy stosować zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

- podłogi i posadzki przemysłowe
- dachy płaskie z dowolną warstwą hydroizolacji
- dachy płaskie w układzie stropodachów pełnych
- w budownictwie inżynierskim i drogowym jako wypełnienia konstrukcyjne, szalunki tracone
- jako warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

Zgodnie z normą EN 13163:2012 oczekuje się, że przy równomiernie rozłożonym obciążeniu użytkowym 45 kN/m<sup>2</sup> płyty PODŁOGA/PARKING po 50 latach będą wykazywały 2% lub mniejsze odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu.

## Pakowanie, transport i zalecenia przy stosowaniu płyt styropianowych

Płyty PODŁOGA/PARKING produkowane są w wymiarach 1000x500 mm; grubość płyt od 20 do 500 mm –skokowo, co 10 mm. Występują z dwoma rodzajami krawędzi: płaskie we wszystkich grubościach i frezowane na zakład od 50 do 200 mm.

**Ilość, grubość mm, objętość m<sup>3</sup> i powierzchnia płyt m<sup>2</sup> w paczce.**

Grubość	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Ilość szt. w paczce	3 0	2 0	1 5	1 2	1 0	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3
Obj. paczki płyty gładkie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,28	0,30	0,26	0,28	0,30	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30
Pow. krycia płyty gładkie	1 5	1 0	7,5	6	5	4	3,5	3	3	2,5	2,5	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Obj. paczki płyty frez.	x	x	x	0,29	0,29	0,27	0,27	0,26	0,29	0,26	0,29	0,25	0,27	0,29	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29
Pow. krycia płyty frez.	x	x	x	5,73	4,78	3,82	3,34	2,87	2,87	2,39	2,39	1,91	1,91	1,91	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43

Płyty dostarczane są w oryginalnych opakowaniach producenta opatrzonych etykietą zawierającą wszystkie istotne cechy produktu.

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi. W przypadku długotrwałego działania promieni UV wierzchnia warstwa styropianu może ulec utlenieniu.

EPS jest niedrażniący, nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC i HCFS; należy stosować do temp.80°C bez kontaktu z materiałami reagującymi z EPS powodującymi rozpuszczanie lub pęcznienie (rozpuszczalniki organiczne, smoła, oleje), Jest to materiał kruchy, może być obrabiany zwykłymi narzędziami do cięcia bez szczególnych środków ostrożności.

## Dokumentacja techniczna

- EN 13163:2012 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”
- Deklaracja właściwości użytkowych DWU Nr 11/2013- dokument dopuszczający wyrób do obrotu na terenie UE